



報道関係各位

2018年3月26日
EV Group

EV Group と IBM がレーザー剥離技術のライセンス契約で合意

IBM のハイブリッド・レーザー・リリース・プロセス技術は、EV Group の低温レーザー剥離装置とプロセス・ポートフォリオを補完、優れた柔軟性と高スループットのソリューションを実現

ST. FLORIAN, Austria, March 14, 2018—MEMS、ナノテクノロジーおよび半導体分野向けウェーハ接合装置やリソグラフィ装置のリーディングサプライヤーであるEV Group (EVG)とIBM (NYSE: IBM)は、レーザー剥離技術におけるライセンス契約に署名したことを本日発表いたしました。EVGは、IBMの特許技術であるハイブリッド・レーザー・リリース・プロセスを、自社の先進的かつ生産現場で実証済みの仮接合・剥離装置ソリューションに統合します。これにより、量産顧客が最適な仮接合/剥離プロセス・フローをより柔軟に導入することが可能になります。IBMより付加されるプロセスバリエーションと、それをサポートするEVGの装置ポートフォリオの組み合わせによって、顧客は接合、洗浄、および測定といった幅広いプロセスオプションを選択でき、仮接合・剥離におけるさまざまな要求とアプリケーションに対応可能になります。

EVGのノウハウとIBMからライセンス供与される技術を組み合わせる結果、UVやIRを用いたレーザー剥離の手法および設計(ガラスまたはシリコンを支持基板として使用可能)、さらに接合界面の検査をも包含する先進的なレーザー剥離ソリューションが実現しました。IBMが提供する技術によって、EVGは仮接合・剥離における厳しい要求項目に対応した装置を設計することが可能になりました。これにより、高スループット、高歩留まりのための低ウェーハ応力、レーザー装置やプロセスおよび消耗品等の低所有コストといった各要件を満たします。この最先端EVGソリューションには、チップを熱とレーザーによる損傷から保護する技術と、デバイスやキャリアウェーハの薬液洗浄技術も含まれています。

EVGの知的財産・技術開発本部のディレクターを務めるマーカス・ウィンプリンガーは次のように述べています。「IBMとの契約により、EV Groupは大量生産を行う弊社のお客様に包括的で柔軟な技術を提供できるようになりました。これにより、お客様は付加価値の高いデバイスをより柔軟に、高いスループットとコスト効率で製造することが可能になります。」

IBM Researchのマイクロシステム・テクノロジー & ソリューションズ担当マネージャーである、ジョン・ニッカーボック博士は次のように述べています。「ガラスまたはシリコン・キャリアウェーハを使用したレーザー剥離技術は、高スループットを生かした効率的なプロトタイプングや低所有コスト、および小型化を実現するプラットフォームを提供することができます。製作実証や応用事例の範囲は、携帯電話や医療およびIoTマイクロシステムを含み、ますます拡大しています。たとえば、センサーおよび小型部品のハンドリング、バイオセンサーやバイオチップとそれを用いた診断システム、そして人工知能ソリューションなどが挙げられます。」

EVGのレーザー剥離モジュールは、同社の標準であるEVG®850DB自動剥離装置に統合可能なよう設計され、固体レーザーと独自のビーム成型光学系を組み合わせることで、剥離力に依存しない理想的な剥離を可能にします。低温での剥離と高温プロセスでの安定性を特徴としたEVGのレーザー剥離ソリューションは、様々なアプリケーションに利用可能です。これらには、ファンアウト型ウェーハレベルパッケージング(FO-WLP)や、温度に敏感

-more-

なプロセス—たとえばメモリの積層・集積化、ダイ分割、ヘテロジニアスインテグレーション、バイオテクノロジーに関連した有機体の封止やデバイスアプリケーションの他、フォトニクス、化合物半導体、パワーデバイスなどが含まれます。

EVGのレーザー剥離ソリューション及び全自動剥離装置

EVG®850DBに関する詳しい情報は、下記リンク先からも入手可能です。

https://www.evgroup.com/en/solutions/3d-ic/thin_wafer_processing/laser_initiated_debonding



写真: EVGのレーザー剥離モジュールは、固体レーザーと独自のビーム成型光学系を組み合わせることで、剥離力に依存しない理想的な剥離を可能にします。また、同社の標準であるEVG®850DB自動剥離装置に統合可能なよう設計されており、ファンアウト型ウェーハレベルパッケージング(FO-WLP)、メモリの積層・集積化、バイオテクノロジー、フォトニクス、化合物半導体、パワーデバイスなど様々なアプリケーションに利用可能です。

〈EV Groupについて〉

EV Group (EVG) は半導体、MEMS、化合物半導体、パワーデバイスおよびナノテクノロジーデバイスの製造装置およびプロセスソリューションのリーディングサプライヤーです。主要製品は、ウェーハ接合、薄ウェーハプロセス、リソグラフィ/ナノインプリントリソグラフィー (NIL) や計測機器だけでなく、フォトレジストコーター、クリーナー、検査装置などがあります。1980年に設立されたEVGは、グローバルなお客様および世界中のパートナーに対し緻密なネットワークでサービスとサポートを提供します。EVGに関する詳しい情報はwww.EVGroup.comをご参照ください。

本件に関する報道関係の方からのお問い合わせ先

EV Group 問い合わせ窓口:

Clemens Schütte

Director of Marketing & Communications EV Group

Phone: +43 7712 5311 0

E-Mail: Marketing@EVGroup.com

広報代理店 オグルヴィ PR

担当: 竹房、赤松

Tel: 03-5793-2338 Fax: 03-5793-2381

E-mail: chiharu.takefusa@ogilvy.com